

2021年10月26日

各 位

会社名 ニッパツ（日本発条株式会社）
証券コード 5991（東証1部）

半導体プロセス部品(半導体製造装置用部品)の生産能力増強に関するお知らせ

ニッパツ(本社・横浜市、代表取締役社長・茅本隆司)は、半導体プロセス部品の生産能力増強の投資をすることといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 背景

2021年9月6日のプレスリリースにて、当社中期計画に対する4億円の設備投資の前倒しにつきお知らせいたしましたが、半導体製造装置に使用される当社の半導体プロセス部品の需要増の勢いが増してきており、今回更に9億円の設備投資を実施することとなりました。

半導体プロセス部品は、神奈川県伊勢原工場と、2年前に新設した長野県宮田工場の2カ所で生産しておりますが、今回の投資対象は宮田工場になります。

今後も大きな成長が見込まれる半導体プロセス部品の需要増加に対応すべく、宮田工場では建屋の増設等も含め、数十億円規模の更なる生産能力増強を検討しております。計画が確定いたしましたら、改めてお知らせ申し上げます。

2. 概要

① 対 象 工 場	産機生産本部宮田工場
② 所 在 地	長野県上伊那郡宮田村5352-6
③ 投 資 額	9億円
④ 生 産 品 目	半導体プロセス部品
⑤ 着 工 予 定	2021年10月
⑥ 稼 働 予 定	2022年10月

【本件に関する問い合わせ先】

ニッパツ 広報グループ

Tel. 045-786-7513

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 3-10

以上